

### 产品

PMplast TPA 190 BK 是一种基于成熟高性能共聚多酰胺化学的黑色低压成型树脂。专为热熔胶应用而设计。

PMplast TPA 190 BK 满足电子业的最新要求，例如防水、防尘及化学品防护。

PMplast TPA 190 BK 不含铅，且其配方中不含硅酮或 PAK。同时还满足 ROHS 指令。

热熔胶在热学和介电性能方面具有卓越的性能，而且在环境压力下也可保持这些性能。

### 应用

电子涂料：

- PCB 的主体侵蚀性环境为汽车或航海导航工业

### 主要性能

- 粘性熔融行为中等
- 对大部分表面具有良好的吸附力
- 符合 ROHS 规范
- UL 94 V0 (内部测试)
- 无需固化

### 抵抗恶劣环境

带 PMplast TPA 190 BK 涂料的电子元件能最大限度地抵抗污染物，如灰尘和许多化学品。还能承受腐蚀性气体环境、弱酸、燃料、油、乙二醇及许多汽车和船舶业中使用的其他液体。

涂层可保持良好的附着力，但其持久柔韧性又可承受部件的变形。

### 加工

PMplast TPA 190 BK 针对自动和半自动应用的大批量生产进行了优化。

如果使用了原装密封袋，则可即开即用。

如果袋子被打开了，则需进行干燥步骤（60° C 时最少 4 小时）以减少吸附水含量。建议在使用后再次焊上袋子。

为了借助 PMPLAST TPA 190-BK 实现良好的润湿和无故障附着，确保其与所使用产品的所有部件的兼容性很重要。而且模具的设计也很重要。

清洗后可优化附着力（例如部件的等离子处理或常规洗涤）。

融化温度范围	210 - 230° C
成型温度范围	20 - 60° C
干燥时间，除湿干燥器	4 - 6 小时
干燥温度	60 - 80° C
加工水分含量	< 0,2%

## 标准数据

融化, C&B ASTM D3461	183 ± 8° C
220° C 时熔体粘度, ASTM D3236	4,0 ± 0,5 Pas
商业形状	粒装
密度, ISO 1183 23° C	0,98 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
室温下保质期	12 个月
玻璃化温度, DSC 二次运行	-50° C
硬度 (Shore D), ISO 868	45
抗张强度, ISO 527-1	> 4 MPa
断裂伸长率, ISO 527-1	> 300 %
拉伸模量, ISO 527-2	无数据
径迹阻力, IEC 60112	无数据
吸水性, ISO 62, 23° C 24 小时	无数据

此数据表中所提供的信息符合我们最新的知识水平与信念, 但所提供的信息仅供参考, 也适用于任何第三方保护权。您仍然有责任对产品进行检查, 了解其是否符合预期的目的和流程。产品的应用、用途和加工超出了我们的合理控制范围, 且将完全由您负责。但是如果仍然出现责任在我方的情况, 该责任也仅限于对任何由我方交付之产品价值所带来的危害。当然, 正如我们的通用条款与条件中所定义的, 我们会对产品的无暇品质承担责任。